

BGA/LGA ソケットクラムシェルタイプ 製品概要

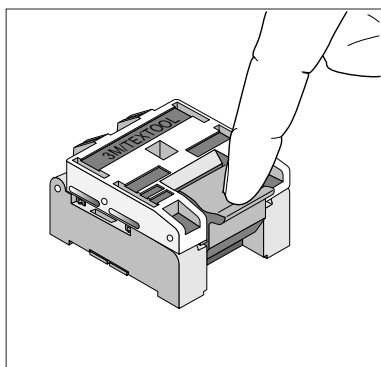
ノーマルリッドメカニズム

ノーマルリッドは簡単なワンアクションによって開閉可能です。プレッシャーパッドは、パッケージの厚さにより設定されます。

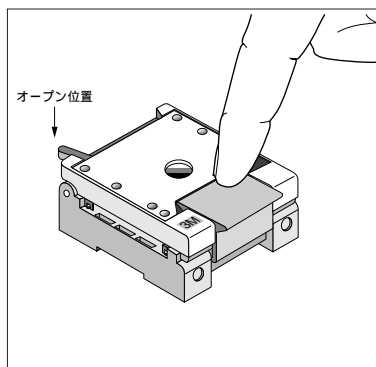
メカニカルリッドメカニズム

メカニカルリッドでは、リッドの開閉動作を2段階にすることで、操作力を1/10に低減しています。これは、多ピンのパッケージにおいて特に効果的です。更にプレッシャーパッドが垂直に押し下げられるため、パッケージには常に均等な荷重を与えることができます。プレッシャーパッドはパッケージの厚さにより設定されます。

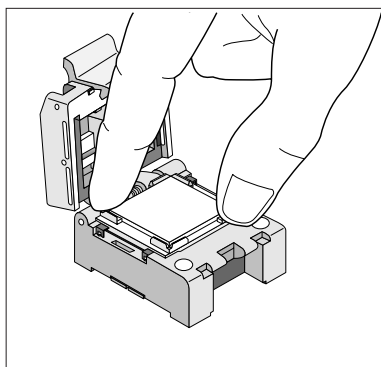
B



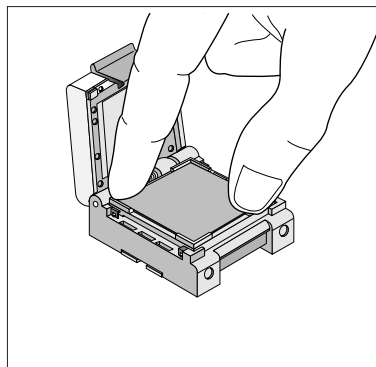
1
ラッチ上面の後部を押し下げることにより、ロック機構を解除します。



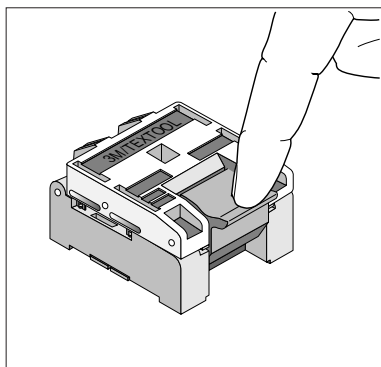
1
ラッチ上面の後部を押し下げることにより、ロック機構を解除します。
注意: 解除前にレバー(バドル)がオープン位置にある事を確認してください。



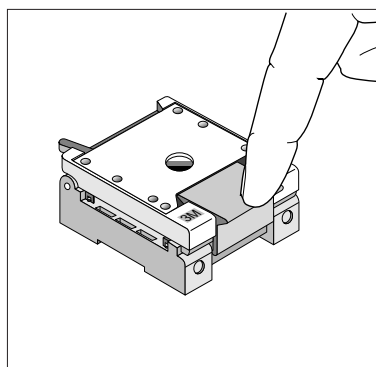
2
パッケージをパッケージガイド内に搭載します。
注意: 台座(ネスト)単体で押し下げないでください。



2
パッケージをパッケージガイド内に搭載します。
注意: 台座(ネスト)単体で押し下げないでください。

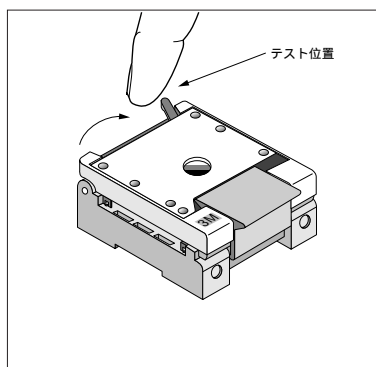
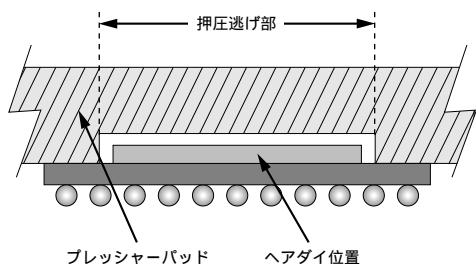


3
ラッチ上面の先端部分を押し下げることにより、リッドが閉じ導通が得られます。



3
ラッチ上面の先端部分を押し下げることにより、リッドが閉じます。

全タイプリッド内の押圧逃げ部
ヘアダイやMCM等の特殊なデバイスにおいてもチップに負荷をかけないようにプレッシャーパッドを加工することが可能です。



4
レバー(バドル)をテスト位置にすることで導通が得られます。逆の手順によりパッケージを取り出すことができます。